

2014-2020年中国半导体材料市场深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2020年中国半导体材料市场深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/xincailiao1409/R91894LZJW.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-09-13

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2020年中国半导体材料市场深度调研与投资前景研究报告》共十四章，报告对我国的市场环境、生产经营、产品市场、技术水平、产业链运行、企业竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

第一部分半导体材料行业发展概述

第一章半导体材料产业基本概述

第一节半导体材料的概述

一、半导体材料概念

二、半导体材料的分类

三、半导体材料的特点

四、化合物半导体材料介绍

第二节半导体材料特性和制备

一、半导体材料特性和参数

二、半导体材料制备

第二章2012-2013年半导体材料发展基本概述

第一节主要半导体材料概况

一、半导体材料的特性和参数

二、半导体材料的种类

三、半导体材料的制备

第二节其他半导体材料的概况

一、非晶半导体材料概况

二、GaN材料的特性与应用

三、可印式氧化物半导体材料技术发展

第三章2012-2013年世界半导体材料产业运行形势综述

第一节2012-2013年全球总体市场发展分析

- 一、全球半导体产业发生巨变
- 二、世界半导体产业进入整合期
- 三、全球半导体产业新进展
- 四、国际半导体市场增长减缓

第二节2012-2013年主要国家或地区半导体材料行业发展分析

- 一、比利时半导体材料行业分析
- 二、德国半导体材料行业分析
- 三、日本半导体材料行业分析
- 四、韩国半导体材料行业分析
- 五、中国台湾半导体材料行业分析

第四章 中国半导体材料行业发展环境分析

第一节 国内宏观经济环境分析

- 一、GDP历史变动轨迹分析
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析
- 三、2013年中国宏观经济发展预测分析

第二节 中国半导体材料行业政策环境分析

第五章2012-2013年中国半导体材料行业运行动态分析

第一节2012-2013年中国半导体材料行业发展概述

- 一、全球代工将形成两强的新格局
- 二、应加强与中国本地制造商合作
- 三、电子材料业对半导体材料行业的影响

第二节2012-2013年半导体材料行业企业动态

- 一、元器件企业增势强劲
- 二、应用材料企业进军封装
- 三、新政策对半导体材料业的作用

第三节2012-2013年中国半导体材料发展存在问题分析

第六章2012-2013年中国半导体材料行业技术分析

第一节2012-2013年半导体材料行业技术现状分析

- 一、硅太阳能技术占主导

二、有机半导体TFT的应用

第二节2012-2013年半导体材料行业技术动态分析

一、功率半导体技术动态

二、闪光驱动器技术动态

三、封装技术动态

四、太阳光电系统技术动态

第三节2014-2020年半导体材料行业技术前景分析

一、高能效驱动方案前景分析

二、计算机芯片技术前景分析

三、太阳能产业技术前景分析

第七章 2012-2013年中国半导体材料氮化镓产业运行分析

第一节2012-2013年中国第三代半导体材料相关介绍

一、第三代半导体材料的发展历程

二、第三代半导体材料得到推广

三、宽禁带半导体材料

第二节2012-2013年中国氮化镓的发展概况

一、氮化镓半导体材料市场的发展状况

二、氮化镓照亮半导体照明产业

三、GaN蓝光产业的重要影响

第三节 2012-2013年中国氮化镓的研发和应用状况

一、中科院研制成功氮化镓基激光器

二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化

三、非极性氮化镓材料的研究有进展

四、氮化镓的应用范围

五、氮化镓晶体管的应用分析

第八章 2012-2013年中国其他半导体材料运行局势分析

第一节砷化镓

一、砷化镓单晶材料的发展

二、砷化镓的特性

三、砷化镓产业的发展应用状况

四、我国最大的砷化镓材料生产基地投产

第二节碳化硅

一、半导体材料碳化硅介绍

二、碳化硅材料的特性

三、高温碳化硅制造装置的组成

四、我国碳化硅的研发与产业化项目取得重大突破

第九章2010-2013年国内半导体材料行业（所属行业）数据监测分析

第一节 2010-2013年中国半导体材料行业（所属行业）总体数据分析

一、2011年中国半导体材料行业全部企业（所属行业）数据分析

二、2012年中国半导体材料行业全部企业（所属行业）数据分析

三、2013年中国半导体材料行业全部企业（所属行业）数据分析

第二节 2010-2012年中国半导体材料行业（所属行业）不同规模企业数据分析

一、2011年中国半导体材料行业（所属行业）不同规模企业数据分析

二、2012年中国半导体材料行业（所属行业）不同规模企业数据分析

三、2013年中国半导体材料行业（所属行业）不同规模企业数据分析

第三节 2010-2012年中国半导体材料行业（所属行业）不同所有制企业数据分析

一、2011年中国半导体材料行业（所属行业）不同所有制企业数据分析

二、2012年中国半导体材料行业（所属行业）不同所有制企业数据分析

三、2013年中国半导体材料行业（所属行业）不同所有制企业数据分析

第十章2012-2013年中国半导体市场运行态势分析

第一节LED产业发展

一、国外LED产业发展情况分析

二、国内LED产业发展情况分析

三、LED产业所面临的问题分析

四、2014-2020年LED产业发展趋势及前景分析

第二节集成电路

一、中国集成电路销售情况分析

二、集成电路产量统计分析

四、半导体集成电路产业发展趋势

第三节电子元器件

一、电子元器件的发展特点分析

二、电子元件产量分析

三、电子元器件的消费趋势分析

第四节半导体分立器件

一、半导体分立器件市场发展特点分析

二、半导体分立器件产量分析

三、半导体分立器件发展趋势分析

第五节其他半导体市场

一、半导体气体与化学品产业发展概况

二、IC光罩市场发展概况

三、中国电源管理芯片市场概况

第三部分半导体材料行业竞争分析

第十一章2012-2013年中国半导体材料行业市场竞争态势分析

第一节2012-2013年国外年半导体材料行业竞争分析

一、2012-2013年欧洲半导体行业竞争机构分析

二、2012-2013年欧洲半导体产业竞争分析

第二节2012-2013年我国半导体材料市场竞争分析

一、半导体照明应用市场竞争分析

二、单芯片市场竞争分析

三、太阳能光伏市场竞争分析

第三节2012-2013年我国半导体材料企业竞争分析

一、国内硅材料企业竞争分析

二、政企联动竞争分析

第十二章2012-2013年中国半导体材料主要生产商竞争性财务数据分析

第一节有研半导体材料股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第二节天津中环半导体股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力及偿债能力分析

第三节宁波康强电子股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力及偿债能力分析

第四节南京华东电子信息科技股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力及偿债能力分析

第五节峨眉半导体材料厂

- 一、企业基本概况
- 二、企业销售收入及盈利水平分析
- 三、企业资产及负债情况分析
- 四、企业成本费用情况

第六节洛阳中硅高科有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业销售收入及盈利水平分析
- 三、企业资产及负债情况分析
- 四、企业成本费用情况

第七节北京国晶辉红外光学科技有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业销售收入及盈利水平分析
- 三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第八节北京中科镓英半导体有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第九节上海九晶电子材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十节东莞钛升半导体材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十一节河南新乡华丹电子有限责任公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十三章2014-2020年中国半导体材料行业发展趋势分析

第一节2014-2020年中国半导体材料行业市场趋势

一、2014-2020年国产设备市场分析

二、市场低迷创新机遇分析

三、半导体材料产业整合

第二节2014-2020年中国半导体行业市场发展预测分析

一、全球光通信市场发展预测分析

二、化合物半导体衬底市场发展预测分析

第三节2014-2020年中国半导体市场销售额预测分析

第四节2014-2020年中国半导体产业预测分析

- 一、半导体电子设备产业发展预测分析
- 二、GPS芯片产量预测分析
- 三、高性能半导体模拟器件的发展预测

第十四章 博思数据关于半导体材料行业投资咨询分析

第一节2014-2020年中国半导体材料行业投资环境分析

第二节2014-2020年中国半导体材料行业投资机会分析

- 一、半导体材料投资潜力分析
- 二、半导体材料投资吸引力分析

第三节2014-2020年中国半导体材料行业投资风险分析

- 一、市场竞争风险分析
- 二、政策风险分析
- 三、技术风险分析

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2012年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2012年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2013年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2013年中国GDP增速预测

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，银行采集数据、税务部门采集数据、证券交易采集数据，商务部采集数据以及经济信息中心各类市场监测数据库

。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/xincailiao1409/R91894LZJW.html>